

PRESSEINFORMATION

PRESSEINFORMATION

18.10.2017 | Seite 1

PolyPhotonics Berlin: Fraunhofer HHI und Partner präsentieren Optochips auf Polymerbasis

Im Rahmen der „Photonik Tage Berlin Brandenburg“ stellt sich der Wachstumskern „PolyPhotonics Berlin“ der Öffentlichkeit vor. „Great in Optics – Small in Size“ ist der Slogan, mit dem PolyPhotonics Berlin der Innovationsinitiative „Unternehmen Region“ des Bundesforschungsministeriums auf den Weltmarkt der Kommunikationstechnik vorstößt. Das Konsortium entwickelt für die Wertschöpfungskette zur Herstellung einer neuen Technologieplattform.

Elf regionale Unternehmen und drei Forschungseinrichtungen haben sich für PolyPhotonics Berlin zusammengefunden. In diesem Verbund sind die Partner erstmals in der Lage, umfassende Lösungen im Anwendungsfeld optischer Komponenten auf Polymerbasis zu realisieren, die in dieser Form bisher weltweit noch nicht verfügbar sind. Zielstellung ist die Entwicklung von innovativen Materialien und Verfahren zur Herstellung und Montage von photonischen Bauelementen, die vielfältig eingesetzt werden können.

Christian Rickerts, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sagt dazu: „Die Technologieplattform PolyPhotonicsBerlin zeigt, dass die Hauptstadt beim Thema Digitalisierung auch in der Hardwareentwicklung für die optische Kommunikationstechnik über ein herausragendes Standortprofil verfügt. Die PolyPhotonics Partner werden mit einer neuen Generation von Polymerchips Vorreiter auf dem Weltmarkt für optische Kommunikationstechnik sein. Das Land Berlin hat mit der Förderung der Verbundprojekte „Berlin Access“ und „100x100 Optics“ über den Zukunftsfonds einen wichtigen Beitrag zur Initiierung der neuen Technologieplattform geleistet.“

Die PolyPhotonics Berlin Technologieplattform stellt einen hybrid-optischen „Baukasten“ dar, mit dem mittels geeigneter Technologien optische Basiselemente zu komplexen, modular und flexibel aufbaubaren und äußerst kompakten Funktionskomponenten integriert werden können (Hybridintegration). Den Kern der Plattform bildet ein Chip mit optischen Wellenleitern aus Polymermaterial, der weitere passive Elemente wie Glasfasern, Dünnschichtfilter oder Mikrooptiken sowie aktive Bauelemente wie Fotodioden oder Laserchips aufnehmen kann.